

■ ■ ■ 導電性接着剤

ECA300/3001

エポキシ系銀ペースト

熱密度の高いデバイス、Siチップサイズの大きいデバイスへの対応

導電性接着剤【ECA300/3001】は1液・銀-エポキシ系の接着剤です。

硬化後、Ag粒子の焼結→高導電、高熱伝導「体積抵抗率 $\times 10^{-5}\Omega\cdot\text{cm}$ 、熱伝導率 $20\text{W/m}\cdot\text{K}$ 」。

硬化後、低弾性率→応力緩和「弾性率 430MPa 」。

Electrically Conductive

Adhesive

ECA series

2017/3/23
ECA300/3001
リーフレット
ver.1.02J

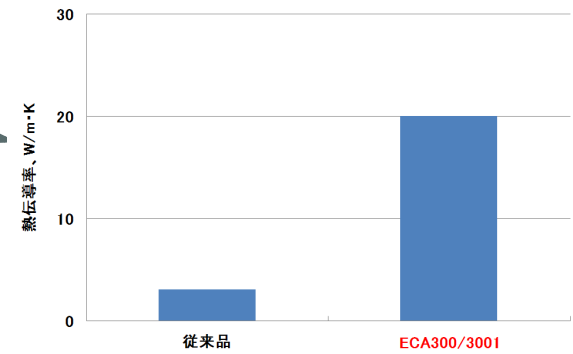
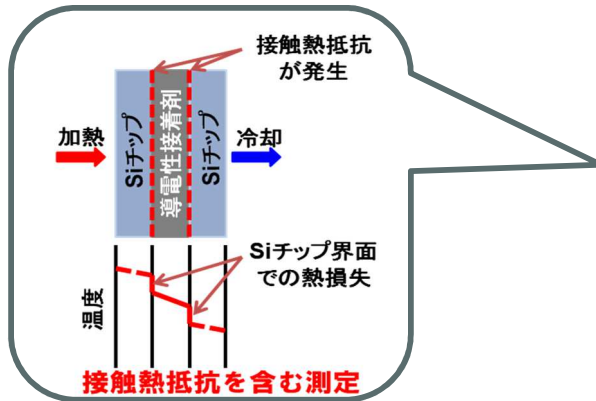
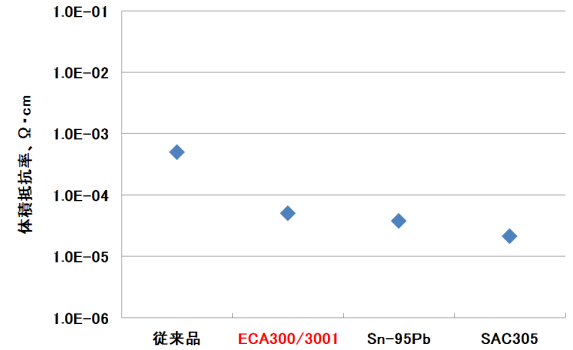
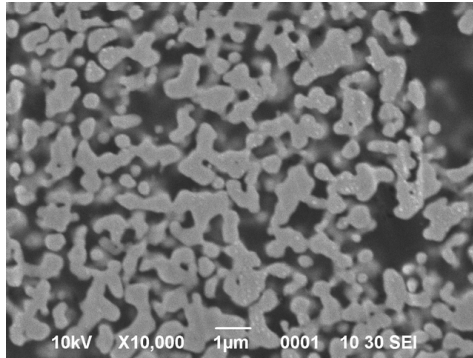
■ ■ ■ 製品の特長

	製品名	ECA300 (無溶剤タイプ)	ECA3001 (溶剤タイプ)	試験方法
硬化前特性	外観	一液銀色ペースト	一液銀色ペースト	-
	粘度(Pa·s)	200	50	E型粘度計
	比重	4.0	3.8	JIS Z 8804
	保管条件(-20°C)	6ヶ月	6ヶ月	弊社試験法
硬化後特性	硬化条件	200°C/1h	80°C/0.5h →200°C/1h	弊社試験法
	ダイシエア強度(MPa)	18.4	18.9	ボンドテスター
	体積抵抗率($\Omega\cdot\text{cm}$)	5.7×10^{-5}	5.4×10^{-5}	JIS K 7194
	熱伝導率(W/m·K)	20	20	定常法
	弾性率@25°C(MPa)	430	560	DMA
ガラス転移温度(°C)	12	16	DMA	

ここに記載された事項は、細心の注意を払って行った実験に基づくものですが、実際の現場結果を保証するものではありません。
また、ご使用の際には必ず安全データシート(SDS)をよくお読みの上、お取扱ください。

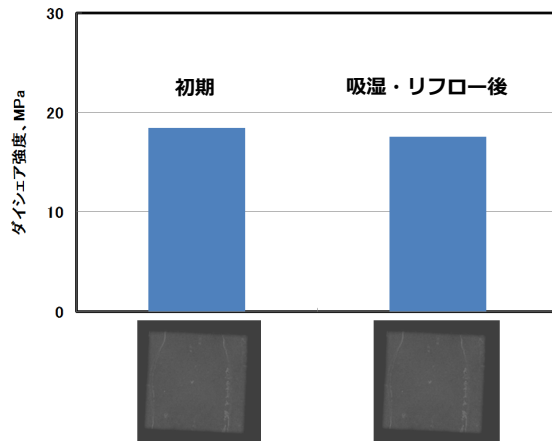
高導電・高熱伝導性

樹脂中でA g 粒子が焼結することで高導電、高熱伝導性を実現



吸湿・リフロー耐性

吸湿・リフロー後も剥離がありません

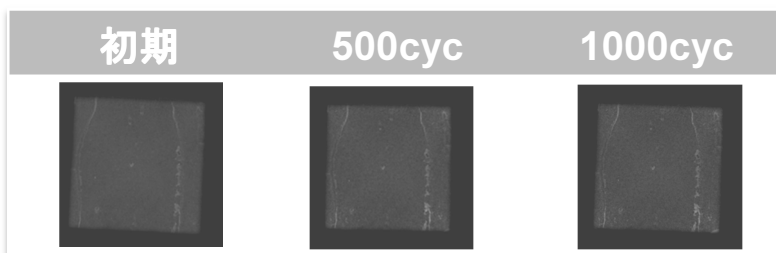


ダイシエア強度試験
 チップ 2.5mm \square Si t0.725mm
 基板 Cu板 t1.0mm
 試験条件 85°C85%RH・168h
 →260°C/30sec×3回

SAT像
 チップ 8.0mm \square Si t0.625mm
 基板 Cu板 t1.0mm
 試験条件 85°C85%RH・168h
 →260°C/30sec×3回

低弾性率による応力緩和

温度サイクル時、初期から1000cycまで変化がありません



チップ 8.0mm \square Si t0.625mm
 基板 Cu板 t1.0mm
 試験条件 -40°C \leftrightarrow +125°C 30min